

上海新阳半导体材料股份有限公司 关于向建设银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于向建设银行申请贷款授信额度的议案》。

为优化公司资产负债结构，统筹安排生产经营资金需求，公司向中国建设银行股份有限公司松江支行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元，期限一年。（在董事会批准范围内实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。

公司董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2018 年 10 月 28 日